



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS MANAUS-DISTRITO INDUSTRIAL

Unidade Curricular	TÉCNOLOGIA DE MONTAGEM EM SUPERFÍCIE		
Período letivo:	SEXTO	Carga Horária:	80h
Objetivos			
<ul style="list-style-type: none">❖ Apresentar técnicas de montagem de dispositivos eletrônico em superfície - SMT.❖ Conhecer ferramentas, equipamentos, componentes e materiais utilizados no processo;❖ Conhecer técnicas de retrabalho.			
Ementas			
<ul style="list-style-type: none">❖ Unidade 1 - Introdução à Tecnologia SMT: Vantagens e desvantagens; Tecnologia PTH e SMT; Termos técnicos utilizados; Tipos de processos.❖ Unidade 2 - Processo de montagem: Fluxo de montagem; Tipos de componentes e suas embalagens; Componentes do processo de montagem; Etapas do processo.❖ Unidade 3 - Pasta de Solda: Composição; Processo de soldagem; Refusão.❖ Unidade 4 - Inspeção e retrabalho: Materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas; Tipos de inspeção; Processo de retrabalho.			
Pré-requisitos			
Nenhum			
Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)			

Título/Periódico	Autor	Edição	Local	Editora	Ano	LT ¹
Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)						
Título/Periódico	Autor	Edição	Local	Editora	Ano	LT ¹
Outros	[1] Apostilas do curso SMT níveis 1 e 2, FUJI ; [2] Desk Reference Manual, IPC-DRM-SMT-C; [3] Desk Reference Manual, IPC/IEA J-STD-001C; [4] Apresentações feitas pela empresa FINETECH GMBH & Co. Kg – Workshop Rework Lead Free, 2006.					

¹ LT - Livro Texto? Sim/Não